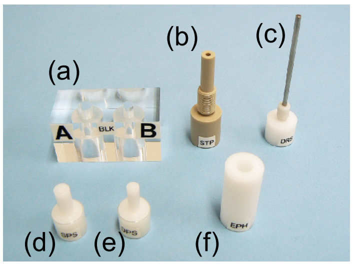
013340 DRE-DCP ディスク電極交換研磨ツール



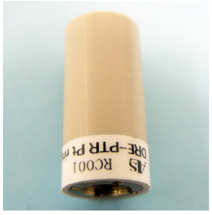
キット内容
(a)DRE-BLK ベースブロック
(b)DRE-STP ストッパー
(c)DRE-DRS ディスク取出棒
(d)DRE-SPS スペーサー押込棒
(e)DRE-DPS ディスク押込棒
(f)DRE-EPH 電極研磨ホルダー

この商品はRRDE用ディスク交換式電極(DRE)の組立、分解に使用するツールキットで、DRE-PTR Ptリングアッセンブリー(013337)、DRE-GCD GCディスク(013338)、DRE-SPCテフロンスペーサー(013339)(3個)は含まれておりません。

ディスク交換式電極(DRE)用パーツ注意点
DRE-PTR、DRE-GCD、DRE-SPCには電極面、接続面があります。
DRE-PTRのPtリング電極は電極面、真鍮コンタクトが接続面です。
DRE-GCDの接続面は面取り加工されています。
DRE-SPCの接続面は小さな穴と面取り加工があります。
組立時の向きに注意してください。逆にして組立てた場合の保証はできません。

電極面 ↕ 接続面

DRE-PTR Ptリングアッセンブリー
(013337)



DRE-GCD GCディスク
(013338)

DRE-SPCテフロンスペーサー
(013339)

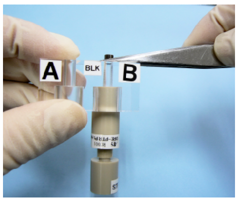
DRE組立方法はリングアッセンブリーの電極面からディスク電極をセットする前面組立方法と接続面からディスク電極をセットする背面組立方法の両方が行えます。
前面組立方法ではディスク電極に前処理を特別必要としない測定に、背面組立方法ではディスク電極に前処理を行う測定に適しています。

1.DRE前面組立方法

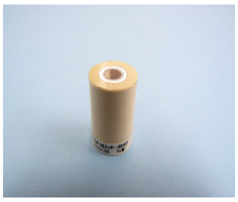
1-1. DRE-PTR Ptリングアッセンブリー(013337)の電極面を、DRE-BLK ベースブロックのAの大穴に奥までしっかりとはめ込みます。

1-2. DRE-SPC テフロンスペーサー(013339)を接続面からベースブロックのAの小穴へ入れます。向きに注意してください。DRE-SPS スペーサー押込棒でスペーサーをアッセンブリー内へしっかりと押込みます。

1-3. アッセンブリーをベースブロックから外しDRE-STP ストッパーを装着します。ストッパーをねじ込みアッセンブリー表面とスペーサーの高さを合わせます。ストッパーを付けたアッセンブリーをベースブロックのBの大穴にしっかりとはめ込みます。



1-4. DRE-GCD GCディスク (013338)を接続面からベースブロックのBの小穴へ入れます。向きに注意してください。DRE-DPS ディスク押込棒でGCディスクをスペーサー内にしっかりはめ込みます。

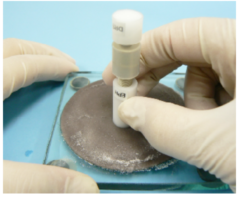


1-5. ストッパーを通してアッセンブリーにDRE-DRS ディスク取出棒を挿入し、電極表面の高さ調整を行います。
組み立てた電極は使用前に研磨してください。研磨方法は当社ウェブサイトをご確認ください。
http://www.bas.co.jp/polishing.html

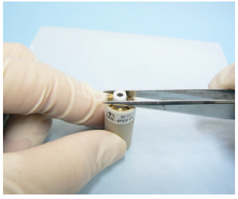
2.DRE背面組立方法

2-1. DRE-EPH 電極研磨ホルダーにストッパーを軽く取り付けベースブロックのAの大穴にセットします。スペーサーをベースブロックのAの小穴に接続面から入れ研磨ホルダーに装着します。研磨ホルダーをベースブロックから外し、ストッパーで高さを調整します。

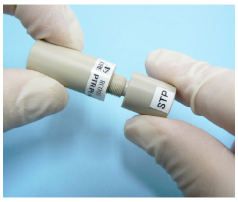
2-2. スペーサーを取り付けた研磨ホルダーをベースブロックのBの大穴に入れます。GCディスクを接続面からBの小穴に入れ、ディスク押込棒でスペーサー内に挿入します。



2-3. ディスク取出棒を研磨ホルダーに取り付け、ディスクとスペーサーの高さをあわせて研磨します。アッセンブリーの研磨は013336 DRE-PGK あるいは013337 DRE-PTRに付属の取扱説明書をご確認ください。



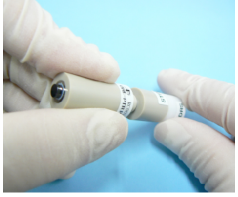
2-4. 研磨ホルダーのストッパーをねじ込みディスクとスペーサーのセットを外します。ディスクへの前処理はセットの状態で行ってください。前処理したセットを電極面からアッセンブリーの接続面へ入れます。



2-5. アッセンブリーにストッパーをねじ込み、ディスクとスペーサーのセットをリング電極表面の高さにあわせます。飛び出した場合はストッパーでセットをアッセンブリーから出して再び入れなおしてください。

3.DRE分解方法

3-1.電極背面からストッパーをテフロンスペーサーに接触するまでねじ込みます。ディスク取出棒をストッパーにねじ込みます。



3-2.ディスク取出棒をねじ込み、ディスク電極を取出します。

3-3.ストッパーを最後までねじ込みテフロンスペーサーを取り外します。

ご注意
DREでの回転電極測定は回転数範囲は前面組立方法は3000 rpm以下、背面組立方法は2000 rpm以下で行ってください。それ以上の回転数での測定は保証できません。
DRE-SPC テフロンスペーサーは消耗品です。歪んだ場合などはすぐに交換してください。
組立工程でDRE-PRT Ptリングアッセンブリー、DRE-SPC テフロンスペーサー、DRE-GCD GCディスクの電極表面の高さがズレた場合、測定結果に悪影響を及ぼします。

弊社HPにより詳細な組立方法やデータを掲載しています。
http://www.bas.co.jp/dre.html

ビー・エー・エス株式会社
http://www.bas.co.jp　　e-mail:sales@bas.co.jp